

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年4月28日(28.04.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/085051 A1

(51) 国際特許分類:
H05K 13/04 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/039286

(22) 国際出願日: 2020年10月19日(19.10.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 株式会社新川(SHINKAWA LTD.) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 Tokyo (JP).

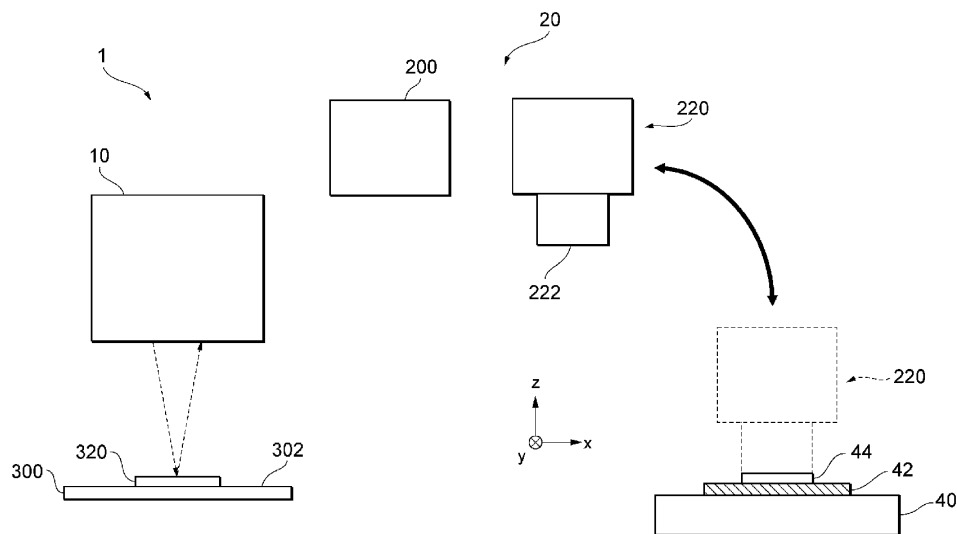
(72) 発明者: 吉田 信一 (YOSHIDA, Shinichi); 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 稲葉 良幸, 外(INABA, Yoshiyuki et al.); 〒1066123 東京都港区六本木 6 - 1 0 - 1 六本木ヒルズ森タワー 2 3 階 T M I 総合法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: MEASUREMENT DEVICE, MEASUREMENT METHOD, AND BONDING SYSTEM

(54) 発明の名称: 測定装置、測定方法及びボンディングシステム



(57) Abstract: The present invention can provide a measurement device, a measurement method, and a bonding system, which enable estimation of the state of the underside of an electronic component that is mounted on a substrate. A measurement device 10 performs measurements on an electronic component 320 that is mounted on a main surface of a substrate 300, the measurement device comprising: a measurement unit 120 that measures a component height position, which is the height of the top surface of the electronic component 320, and a substrate height position, which is the height of a

[続葉有]

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

non-mount region of the main surface of the substrate 300 where the electronic component 320 is not mounted; and an estimation unit 114 that estimates position information relating to a mount region of the main surface of the substrate 300 where the electronic component 320 is mounted, on the basis of the component height position and the substrate height position as measured by the measurement unit 120.

(57) 要約: 基板に実装されている電子部品の下面側の状態を推定することを可能とする測定装置、測定方法及びボンディングシステムを提供することができる。測定装置10は、基板300の主面に実装された電子部品320に対して測定を行うものであって、電子部品320の上面の高さ位置である部品高さ位置と、基板300の主面のうちの電子部品320が実装されていない非実装領域の高さ位置である基板高さ位置とを測定する測定部120と、測定部120により測定された部品高さ位置及び基板高さ位置に基づいて、基板300の主面のうちの電子部品320が実装されている実装領域に関する位置情報を推定する推定部114と、を備える。